

디아이 (003160)

Company Issue Brief | 테크 미드/스몰캡

NR

목표주가	NR
현재주가	19,790 원
시가총액	5,601 억원
KOSPI (5/22)	2,723.46 pt

HBM용 Test 장비 국산화 수혜 전망

Analyst 차용호 _ eunyeon9569@ebestsec.co.kr

컨센서스 대비

상회	부합	하회

Stock Data

90일 일평균거래대금	625.44 억원
외국인 지분율	9.8%
절대수익률 (YTD)	214.1%
상대수익률(YTD)	211.6%
배당수익률(23)	0.5%

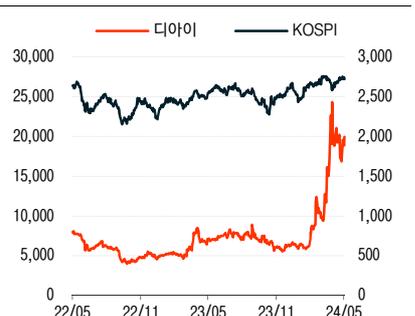
재무데이터

(십억원)	2022	2023	2024E	2025E
매출액	231	215	217	219
영업이익	11	6	10	11
순이익	15	2	1	2
ROE (%)	10.0	2.1	0.9	1.1
PER (x)	8.4	51.7	373.2	324.0
PBR (x)	0.9	1.2	3.7	3.8

자료: 디아이, 이베스트투자증권 리치서센터

주: K-IFRS 연결 기준

Stock Price



기업개요

디아이는 1955년 설립 및 1996년 상장한 반도체 테스트 장비 제조 업체이다. 반도체 테스트 공정은 Wafer 상태에서 양품을 판별하는 Wafer test 공정과 Packaging 이후 출하 전 마지막으로 검사하는 Packaging Test 공정으로 나뉜다. 동사의 주력 제품은 Wafer Test 장비로 별도 기준 삼성전자, 자회사 디지털 프로티어(DF, 지분율 73%) 기준 SK하이닉스에 납품하고 있다. 그 외 주요 연결 자회사로는 디아이씨(반도체 챔버), 디아이머티리얼즈(전자부품), 브이텐 시스템, 프로텍코퍼레이션(2차전지) 등이 존재한다.

HBM용 Burn-In Test 장비 국산화 수혜 전망

현재 HBM Capa 확대의 어려움 중 하나는 테스트 장비 시장을 양분하고 있는 Advantest와 Teradyne의 Capa가 부족하다는 점이다. 따라서 국내 HBM 공급 업체들은 테스트 장비 공급 부족을 해결하기 위해 국산화를 추진 중이다. Wafer Test 내 비교적 난이도가 낮은 Burn-in 공정은 국산 장비를 채택하고 높은 사양이 요구되는 Final Test(EPM 등) 공정을 기존 Advantest 장비로 진행하는 방식이다. HBM용 Wafer Test 장비는 일반 DRAM용 장비 대비 고전류를 요구하지만 DF는 SK하이닉스에게 DDR5 Burn-In 장비를 기납품했기에 기술력은 입증한 것으로 사료된다. SK하이닉스와는 현재 양산 중인 HBM3e는 기존 DDR5 테스트 장비를 업그레이드해서 진행하고 HBM4부터 전용 장비를 개발하는 방식을 논의 중에 있다.

Test 장비 Value Chain 부각

컨센서스 기준 2024년 실적은 매출액 2,561억원, 영업이익 152억원으로 고객사들의 HBM 중심 투자로 다소 부진할 것으로 예상되며 HBM용 Burn-in Test 장비 실적 기여가 본격화되는 2025년부터 성장이 이루어질 것이다. 디아이의 시가총액은 5,601억원으로 테크윙(테스트 핸들러, 1.5조원), 와이씨(테스트 장비, 1.4조원) 대비 낮은 수준이다. 국내 Test 장비 Value Chain 부각 속 디아이는 ① 예상 고객사가 HBM 선두 주자이며 ② 중장기적으로는 Final Test까지 국산화 확대를 목표로 하고 있다는 점에 주목해야 할 것이다.

그림1 디아이 지배구조



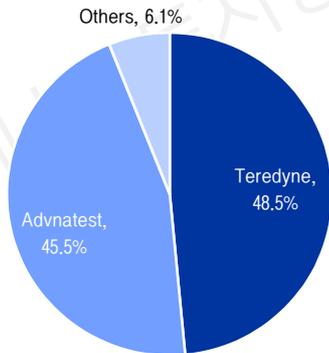
자료: 디아이, 이베스트투자증권 리서치센터

그림2 반도체 TEST 공정



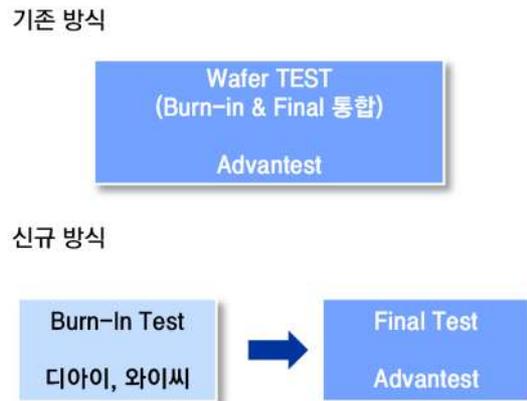
자료: 네댨스아크, 이베스트투자증권 리서치센터

그림3 글로벌 Test 장비 시장 점유율



자료: Gartner, Bloomberg, 이베스트투자증권 리서치센터

그림4 Burn-In Test Test 장비의 국산화



자료: 이베스트투자증권 리서치센터

표1 디아이 연결 실적 추이

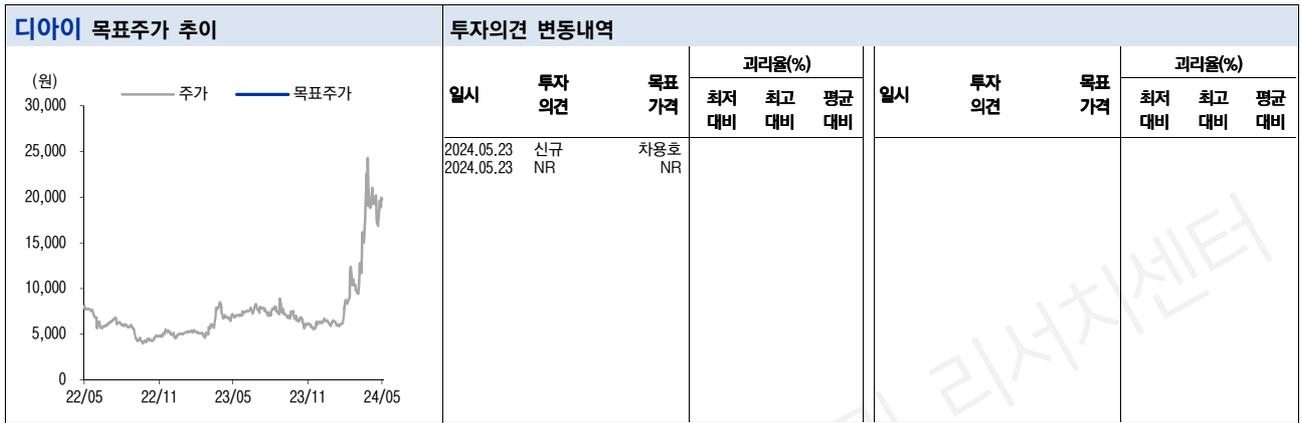
(단위: 십억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2021	2022	2023
반도체 장비	33.8	60.6	50.7	27.8	23.0	210.5	204.4	173.0
전자부품	3.0	3.1	3.6	2.9	3.4	11.8	14.9	12.6
기타 및 연결조정	2.4	0.8	3.3	22.5	8.4	4.2	11.7	29.0
매출액 합계	39.2	64.5	57.7	53.1	34.7	226.6	231.0	214.5
영업이익	0.9	5.6	2.6	-2.9	-1.8	16.5	11.2	6.1
영업이익률	2.2%	8.6%	4.6%	-5.5%	-5.3%	7.3%	4.8%	2.9%

자료: 디아이, 이베스트투자증권 리서치센터

표2 국내 테스트장비 Valuation Table

(단위: 십억원)		매출액	영업 이익	영업 이익률(%)	PER (x)	PBR (x)	EPS (원)	BPS (원)	ROE (%)
디아이 5,601억원	2023	215	6	2.9	56.5	1.1	111	5,836	2.1
	2024E	256	15	6.0	44.6	3.3	448	6,024	8.3
	2025E	474	62	13.1	11.1	2.5	1,792	7,897	28.1
테크윙 1조 4,885억원	2023	134	3	2.4	적자	1.9	-249	6,069	-4.2
	2024E	281	61	21.6	28.3	5.5	1,392	7,191	22.0
	2025E	429	107	24.9	15.5	4.1	2,543	9,737	31.4
와이씨 1조 4,481억원	2023	255	9	3.4	30.2	1.3	165	3,853	4.5
	2024E	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025E	-	-	-	-	-	-	-	-

자료: FnGuide, 이베스트투자증권 리서치센터



Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 차용호).

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- _ 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- _ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- _ 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- _ 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.

투자등급 및 적용 기준

구분	투자등급 guide line (투자기간 6~12개월)	투자등급	적용기준 (향후12개월)	투자 의견 비율	비고
Sector (업종)	시가총액 대비 업종 비중 기준 투자등급 3단계	Overweight (비중확대) Neutral (중립) Underweight (비중축소)			
Company (기업)	절대수익률 기준 투자등급 3단계	Buy (매수) Hold (보유) Sell (매도) 합계	+15% 이상 기대 -15% ~ +15% 기대 -15% 이하 기대	92.4% 7.6%	2018년 10월 25일부터 당사 투자등급 적용기준이 기존 ±15%로 변경
				100.0%	투자 의견 비율은 2023. 4. 1 ~ 2024. 3. 31 당사 리서치센터의 의견공표 종목들의 맨마지막 공표의견을 기준으로 한 투자등급별 비중임 (최근 1년간 누적 기준, 분기별 갱신)